

# Dell EMC PowerEdge C6520

## Teknik Özellikler

## Notlar, dikkat edilecek noktalar ve uyarılar

 **NOT:** NOT, ürününüzü daha iyi kullanmanıza yardımcı olacak önemli bilgiler sağlar.

 **DİKKAT:** DİKKAT, donanım hasarı veya veri kaybı olasılığını gösterir ve sorunu nasıl önleyeceğinizi bildirir.

 **UYARI:** UYARI, mülk hasarı, kişisel yaralanma veya ölüm potansiyeline işaret eder.

<b>Bölüm 1: Teknik özellikler</b> .....	<b>4</b>
Kızak boyutları.....	4
Kasa ağırlığı.....	5
İşlemci özellikleri.....	5
PSU teknik özellikleri.....	5
Desteklenen işletim sistemleri.....	5
Sistem pili özellikleri.....	6
Genişletme kartı yükselticisi teknik özellikleri.....	6
Bellek özellikleri.....	6
Sürücüler.....	7
Depolama özellikleri.....	7
Bağlantı noktaları ve konektörlerin özellikleri.....	8
USB bağlantı noktası özellikleri.....	8
DisplayPort özellikleri.....	8
NIC bağlantı noktası özellikleri.....	8
iDRAC9 bağlantı noktası özellikleri.....	8
Video özellikleri.....	8
Çevre özellikleri.....	9
Partikül ve gaz kirliliği teknik özellikleri.....	10
Termal kısıtlamalar.....	10

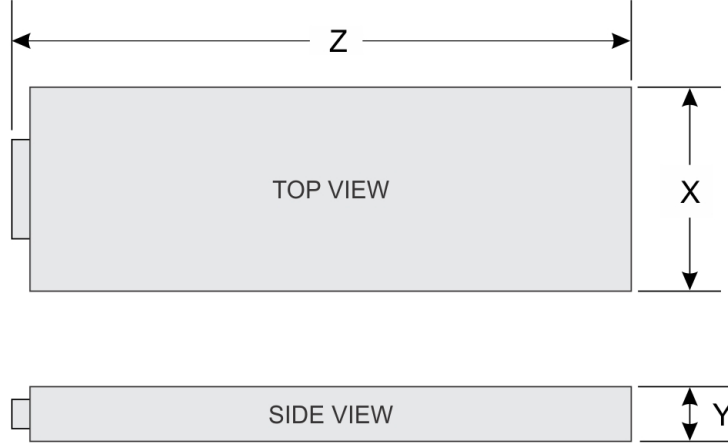
## Teknik özellikler

Bu bölümde sisteminizin teknik ve çevresel özelliklerine değinilmiştir.

### Konular:

- Kızak boyutları
- Kasa ağırlığı
- İşlemci özellikleri
- PSU teknik özellikleri
- Desteklenen işletim sistemleri
- Sistem pili özellikleri
- Genişletme kartı yükselticisi teknik özellikleri
- Bellek özellikleri
- Sürücüler
- Depolama özellikleri
- Bağlantı noktaları ve konektörlerin özellikleri
- Video özellikleri
- Çevre özellikleri

## Kızak boyutları



### Rakam 1. Kızak boyutları

**Tablo 1. PowerEdge C6520 kızak boyutları**

X	Y	Z
447,04 mm (17,6 inç)	86,36 mm (3,4 inç)	802,64 mm (31,6 inç)

# Kasa ağırlığı

Tablo 2. PowerEdge C6520 kızaklı muhafazanın kasa ağırlığı

Sistem yapılandırması	Maksimum ağırlık (tüm kızaklar ve sürücülerle)
12 x 3,5 inç	45,6 kg (100,53 lb)
24 x 2,5 inç	41,4 kg (91,27 lb)
Arka paneli olmayan sistem	35 kg (77,16 lb)

# İşlemci özellikleri

Tablo 3. PowerEdge C6520 işlemci teknik özellikleri

Desteklenen işlemci	Desteklenen işlemci sayısı
40 çekirdeğe kadar çekirdek desteği ile 3. Nesil Ölçeklenebilir Intel Xeon işlemciler	iki

# PSU teknik özellikleri

PowerEdge C6520 sistem, iki adede kadar AC veya DC güç kaynağı ünitesini (PSU) destekler.

Tablo 4. PSU teknik özellikleri

PSU	Sınıf	Isı dağıtımı (maksimum)	Frekans	Gerilim	AC		Akım
					Yüksek hat	Düşük hat 100 - 120 V	
2600 W	Platin Platinum	9750 BTU/sa	50/60 Hz	100 - 240 V otomatik aralıklı	2600 W (220 - 240 V)	1400 W	16 A
2400 W	Platinum	9000 BTU/sa	50/60 Hz	100 - 240 V otomatik aralıklı	2400 W (200 - 240 V)	1400 W	16 A
2000 W	Platinum	7500 BTU/sa	50/60 Hz	100 - 240 V otomatik aralıklı	2000 W (200 - 240 V)	1000 W	11,5 A
1600 W	Platinum	6000 BTU/sa	50/60 Hz	100 - 240 V otomatik aralıklı	1600 W (200 - 240 V)	800 W	10 A

**NOT:** Parça numarası 9D4R6 olan 2600 W PSU yalnızca C14-C19 adaptör kablosunu destekler.

**NOT:** Ayrıca bu sistem fazdan faza gerilimi 240 V değerini geçmeyen BT güç sistemlerine bağlanacak şekilde tasarlanmıştır.

**NOT:** Isı dağıtımı PSU'nun Watt değeriyle hesaplanır.

**NOT:** Sistem yapılandırmanızı seçerken veya yükseltirken, en iyi güç kullanımını sağlamak için sistem güç tüketimini [Dell.com/ESSA](https://www.dell.com/ESSA) adresinde bulunan Dell Energy Smart Solution Advisor (Dell Enerji Akıllı Çözüm Danışmanı) ile doğrulayın.

# Desteklenen işletim sistemleri

PowerEdge C6520 sistem aşağıdaki işletim sistemlerini destekler:

- Canonical Ubuntu Server LTS
- Citrix Hypervisor
- Microsoft Windows Server + Hyper-V
- Red Hat Enterprise Linux

- SUSE Linux Enterprise Server
- VMware ESXi/vSAN
- CentOS
- Windows Önkurulum Ortamı (WinPE) 64 bit sürücüleri

Daha fazla bilgi için [www.dell.com/ossupport](http://www.dell.com/ossupport) adresine gidin.

## Sistem pili özellikleri

PowerEdge C6520 sistem, CR 2032 3,0 V lityum düğme pil destekler.

## Genişletme kartı yükselticisi teknik özellikleri

PowerEdge C6520 sistem en fazla dört PCI express (PCIe) Gen 4 genişletme kartını destekler.

**Tablo 5. Sistem kartında desteklenen genişletme kartı yuvaları**

PCIe yuvası	Yükselticiler	Yükseltici genişliği	PCIe yuvası yüksekliği	PCIe yuvası uzunluğu	PCIe yuvası genişliği
Yuva 1	Yükseltici 1a	x16 PCIe	Düşük profil	Yarım uzunluk	x8
Yuva 1	Yükseltici 1b, SNAP G/Ç modülü ile	x16 PCIe	Düşük profil	Yarım uzunluk	x8 + x8
Yuva 2	Yükseltici 2b	x16 PCIe	Düşük profil	Yarım uzunluk	x8

**NOT:** Genişletme kartı kurulum yönergeleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. sisteme özel *Kurulum ve Servis Kılavuzu* şu adreste mevcuttur: <https://www.dell.com/poweredgemanuals>

## Bellek özellikleri

PowerEdge C6520 sistem en iyi duruma getirilmiş çalışma için aşağıdaki bellek özelliklerini destekler.

**Tablo 6. Bellek özellikleri**

DIMM tipi	DIMM derecesi	DIMM kapasitesi	Tek işlemci		Çift işlemciler	
			Minimum sistem kapasitesi	Maksimum sistem kapasitesi	Minimum sistem kapasitesi	Maksimum sistem kapasitesi
RDIMM	Tek aşamalı	8 GB	8 GB	64 GB	16 GB	128 GB
	Çift aşamalı	16 GB	16 GB	128 GB	32 GB	256 GB
		32 GB	32 GB	256 GB	64 GB	512 GB
		64 GB	64 GB	512 GB	128 GB	1 TB
LRDIMM	Dört aşamalı	64 GB	64 GB	512 GB	128 GB	1 TB
		128 GB	128 GB	1 TB	256 GB	2 TB

**Tablo 7. Bellek modülü soketleri**

Bellek modülü soketleri	Hız
16, 288 pin	3200 MT/sn, 2933 MT/sn, 2666 MT/s

# Sürücüler

PowerEdge C6520 sistemi şunları destekler:

- 12 x 3,5 inç SAS/SATA (HDD/SSD) sürücüsü
- 24 x 2,5 inç SAS/SATA (HDD/SSD) /NVMe sürücüsü.

**Tablo 8. PowerEdge C6520 kızağı için desteklenen sürücü seçeneklerinin maksimum sayısı**

Kızaktaki maksimum sürücü sayısı	Kızak başına atanan maksimum sürücü sayısı
12 x 3,5 inç sürücü sistemi	Kızak başına üç adet SAS veya SATA sürücüsü ve SATA SSD'ler
24 x 2,5 inç NVMe olmayan sürücü yapılandırması	Kızak başına altı adet SAS veya SATA sürücüsü ve SATA SSD'ler
8 x 2,5 inç NVMe sürücü yapılandırması (kızak başına 2 NVMe sürücü / kasa başına 8 NVMe sürücü)	NVMe arka paneli aşağıdaki iki yapılandırmadan birini destekler: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kızak başına iki adet NVMe sürücü ve dört adet SAS veya SATA sürücü ve SATA SSD'ler</li></ul> <b>NOT:</b> NVMe sürücüleri PCIe Gen3 hızıyla sınırlıdır.
24 x 2,5 inç NVMe sürücü yapılandırması	Kızak başına altı adet NVMe sürücü
M.2 SATA sürücü (isteğe bağlı)	M.2 SATA kartının desteklenen kapasitesi 960 GB'a kadardır <b>NOT:</b> M.2 SATA kartı M.2 yükselticisine veya BOSS kartına takılabilir
Önyükleme için Mikro SD Kart (isteğe bağlı) (en fazla 64 GB)	Yükseltici 1a'da bir adet

**NOT:** NVMe PCIe SSD U.2 cihazını çalışırken değiştirme hakkında daha fazla bilgi için, <https://www.dell.com/support> **Tüm Ürünlere Göz At > Veri Merkezi Altyapısı > Depolama Adaptörleri ve Denetleyiciler > Dell PowerEdge Express Flash NVMe PCIe SSD > Belgeler > El Kitapları ve Belgeler adresindeki *Dell Express Flash NVMe PCIe SSD Kullanıcı Kılavuzu*'na bakın.**

## Depolama özellikleri

PowerEdge C6520 kızağı şunları destekler:

**Tablo 9. Sistem için depolama denetleyicisi kartları**

İç denetleyiciler	Harici denetleyiciler
<ul style="list-style-type: none"><li>• PERC H745</li><li>• HBA355i</li><li>• HBA345</li><li>• S150</li><li>• H345</li><li>• Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-S1): HWRAID 2 x M.2 SSD</li><li>• H350</li><li>• H750</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 12 Gb/sn SAS Harc. HBA</li></ul>

**Tablo 10. Desteklenen M.2 SATA sürücülerle RAID seçenekleri**

Seçenekler	RAID olmadan tek M.2 SATA sürücü	Donanımsal RAID olmadan çift M.2 SATA sürücüler
Donanımsal RAID	Hayır	Evet
RAID modu	Yok	RAID 1, RAID 0
Desteklenen sürücü sayısı	1	2
Desteklenen CPU'lar	CPU 1	CPU 1

**i** | **NOT:** RAID seçenekleri yalnızca iki adet M.2 SATA sürücüsünü destekleyen BOSS kartları üzerinde desteklenir.

## Bağlantı noktaları ve konektörlerin özellikleri

### USB bağlantı noktası özellikleri

PowerEdge C6520 kızak, sistemin arka tarafında USB 3.0 destekler.

### DisplayPort özellikleri

PowerEdge C6520 kızak 1 x Mini-DisplayPort 'u destekler.

### NIC bağlantı noktası özellikleri

PowerEdge C6520 kızak, ana kartta (LOM) LAN'a yerleşik olarak ve isteğe bağlı Open Compute Project (OCP) kartlarına entegre olmak üzere bir 10/100/1000 Mb/sn Ağ Arayüzü Denetleyicisi (NIC) bağlantı noktasını destekler.

**Tablo 11. Kızak için NIC bağlantı noktası teknik özellikleri**

Özellik	Özellikler
LOM card	1 GbE
OCP 3.0 kart	1 GbE x 4, 10 GbE x 2, 25 GbE x 2, 25 GbE x 4

### iDRAC9 bağlantı noktası özellikleri

PowerEdge C6520 kızığı sistemin arka tarafında bulunan 1 x iDRAC Direct bağlantı noktası (Micro-AB USB) destekler.

### Video özellikleri

PowerEdge C6520 sistem 16 MB video çerçeve arabellekli tümleşik Matrox G200 grafik denetleyicisini destekler.

**Tablo 12. Sistem için desteklenen ön video çözünürlüğü seçenekleri**

Resolution (Çözünürlük)	Yenileme hızı (Hz)	Renk derinliği (bit)
1024 x 768	60	8, 16, 32
1280 x 800	60	8, 16, 32
1280 x 1024	60	8, 16, 32
1360 x 768	60	8, 16, 32
1440 x 900	60	8, 16, 32
1600 x 900	60	8, 16, 32
1600 x 1200	60	8, 16, 32
1680 x 1050	60	8, 16, 32
1920 x 1080	60	8, 16, 32
1920 x 1200	60	8, 16, 32

## Çevre özellikleri

**i** **NOT:** Çevre sertifikaları ile ilgili ek bilgi için [www.dell.com/support/home](http://www.dell.com/support/home) adresinde bulunan Belgeler bölümünde Ürünün Çevresel Veri Sayfası'na bakın.

**Tablo 13. Çalıştırma iklim aralığı kategorisi A3**

Sıcaklık	Özellikler
İzin verilen sürekli çalışma	
<= 900 metre (<= 2953 fit) yükseklik için sıcaklık aralıkları	Ekipman doğrudan güneş ışığına maruz kalmadan 5-40°C (41-104°F).
Nem yüzdesi aralıkları (her zaman yoğunlaşmayan)	-12°C minimum yoğuşma noktasıyla %8 bağıl nem ve 24°C (75,2°F) maksimum yoğuşma noktasıyla %85 bağıl nem arası
Çalışma yüksekliği oranı azalması	Maksimum sıcaklık 900 m (2953 fit) üzerinde 1°C/175 m (33,8°F/574 fit) oranında düşürülür.

**Tablo 14. Tüm kategorilerde ortak gereksinimler**

Sıcaklık	Özellikler
İzin verilen sürekli çalışma	
Maksimum sıcaklık geçişi (çalışma ve çalışma dışı için geçerlidir)	Bir saatte* 20°C (36°F) ve 15 dakikada 5°C (41°F), bant için bir saatte 5°C (41°F) <b>i</b> <b>NOT:</b> * - Bant donanımı için ASHRAE termal yönergeleri uyarınca bunlar anlık sıcaklık değişiklik oranları değildir.
Çalışma dışı sıcaklık sınırları	-40 ila 65°C (-104 ila 149°F)
Çalışma dışı nem limitleri	27°C (80,6°F) maksimum nem noktasıyla %5 ila 95 bağıl nem.
Maksimum çalışma dışı yükseklik	12.000 metre (39.370 fit)
Maksimum çalışma yüksekliği	3048 metre (10.000 fit)

## Maksimum titreşim özellikleri

**Tablo 15. Maksimum titreşim özellikleri**

Maksimum titreşim	Özellikler
Çalışma	5 Hz - 350 Hz değerlerinde 0,26 Grms (tüm çalışma yönelimlerinde).
Depolama	10 Hz - 500 Hz değerlerinde 15 dakika için 1,88 Grms (altı kenarın tümü test edilmiştir).

## Maksimum sarsıntı darbesi özellikleri

**Tablo 16. Maksimum sarsıntı özellikleri**

Maksimum sarsıntı	Özellikler
Çalışma	11 ms'ye kadar pozitif ve negatif x, y, z eksenlerinde gerçekleştirilen 6 G şiddetinde altı art arda sarsıntı darbesi (sistemin her tarafına dört darbe).
Depolama	2 ms'ye kadar 71 G'lik pozitif ve negatif x, y ve z eksenlerinde (sistemin her tarafında tek darbe) art arda verilen altı sarsıntı darbesi.

## Partikül ve gaz kirliliği teknik özellikleri

Aşağıdaki tabloda herhangi bir BT ekipmanı hasarından ve/veya partikül ve gaz kirlenmesinden kaynaklanan arızalardan kaçınılmasına yardımcı olan sınırlamalar tanımlanmaktadır. Partikül veya gaz kirliliği seviyeleri belirtilen sınırlamaları aşarsa ve ekipmanın hasar görmesine veya arızalanmasına neden olursa, çevre koşullarını düzeltmeniz gerekebilir. Çevresel koşulların iyileştirilmesi müşterinin sorumluluğundadır.

**Tablo 17. Partikül kirliliği teknik değerleri**

Partikül kontaminasyonu	Özellikler
Hava filtreleme	<p>%95 üst güvenlik sınırıyla ISO 14644-1 uyarınca ISO Sınıf 8 ile tanımlanan veri merkezi hava filtrasyonu.</p> <p><b>i</b> <b>NOT:</b> Bu koşul yalnızca veri merkezi ortamları için geçerlidir. Hava filtreleme gereksinimleri, veri merkezi dışında kullanım için tasarlanmış BT ekipmanı, ofis veya fabrika gibi ortamlar için geçerli değildir.</p> <p><b>i</b> <b>NOT:</b> Veri merkezine giren havanın MERV11 veya MERV13 filtrelemesi olmalıdır.</p>
İletken toz	<p>Havada iletken toz, çinko teller veya diğer iletken parçacıklar bulunmamalıdır.</p> <p><b>i</b> <b>NOT:</b> Bu koşul, veri merkezi ortamları ve veri merkezi olmayan ortamlar için geçerlidir.</p>
Aşındırıcı toz	<ul style="list-style-type: none"><li>Havada aşındırıcı toz bulunmamalıdır.</li><li>Havadaki toz kalıntısının havadaki nem ile eriyebilme noktası %60 bağıl nemden az olmalıdır.</li></ul> <p><b>i</b> <b>NOT:</b> Bu koşul, veri merkezi ortamları ve veri merkezi olmayan ortamlar için geçerlidir.</p>

**Tablo 18. Gaz kirliliği teknik değerleri**

Gaz içerikli kirlenme	Özellikler
Bakır Parça Aşınma Oranı	<ANSI/ISA71.04-2013 ile tanımlanan biçimde Sınıf G1 başına ayda 300 Å
Gümüş Parça Aşınma Oranı	ANSI/ISA71.04-2013 tarafından tanımlandığı şekilde <200 Å/ay.

**i** **NOT:** Maksimum aşındırıcı kirlenme düzeyleri  $\leq$ %50 bağıl nemde ölçülmüştür.

## Termal kısıtlamalar

**i** **NOT:**

- Mevcut değil: Yapılandırmanın Dell EMC tarafından sunulmadığını gösterir.
- Desteklenmiyor: Yapılandırmanın termal olarak desteklenmediğini gösterir.

**i** **NOT:** Ortam sıcaklığı bu tablolarda listelenen maksimum sürekli çalışma sıcaklığına eşit veya bu sıcaklıktan daha azsa DIMM'ler, iletişim kartları, M.2 SATA ve PERC kartları dahil olmak üzere tüm bileşenler yeterli termal marj ile desteklenebilir.

**i** **NOT:** Bazı sistem donanım yapılandırmaları, daha düşük bir üst sıcaklık sınırı gerektirir. Çalışma sıcaklığı gereksinimi hakkında daha fazla bilgi için teknik desteğe başvurun.

**i** **NOT:** Bazı yapılandırmalar daha düşük bir ortam sıcaklığı gerektirir. Daha fazla bilgi için aşağıdaki tablolara bakın.

Aşağıdaki tablolarda, sistemde yapılandırılmış CPU'ya bağlı olarak ortam sıcaklığının temel kısıtlamaları listelenir. Aşağıda verilen tüm giriş sıcaklıkları sürekli santigrat derece cinsindedir.

**Tablo 19. Hava soğutmalı - 2,5 inç doğrudan / 2,5 inç NVMe sürücü yapılandırmasına sahip çift işlemci için maksimum sürekli çalışma sıcaklığı**

İşlemciler	TDP (W)	Çekird ekler	6 x sürücü/ kızak	4 x sürücü/kızak	2 x sürücü/kızak	1 x sürücü/ kızak	BP yok
8380	270	40	Desteklenmez	Desteklenmez	Desteklenmez	Desteklenmez	Desteklenmez
8368	270	38	Desteklenmez	Desteklenmez	Desteklenmez	Desteklenmez	Desteklenmez
8368Q	270	38	Desteklenmez	Desteklenmez	Desteklenmez	Desteklenmez	Desteklenmez
8362	265	32	Desteklenmez	Desteklenmez	Desteklenmez	Desteklenmez	Desteklenmez
8360Y	250	36	Desteklenmez	Desteklenmez	Desteklenmez	Desteklenmez	Desteklenmez
8358	250	32	Desteklenmez	Desteklenmez	Desteklenmez	Desteklenmez	Desteklenmez
8358P	240	32	Desteklenmez	Desteklenmez	Desteklenmez	Desteklenmez	20
6348	235	28	Desteklenmez	Desteklenmez	Desteklenmez	Desteklenmez	20
6342	230	24	Desteklenmez	Desteklenmez	Desteklenmez	20	20
8352Y	205	32	20	20	25	25	25
8352S	205	32	20	20	25	25	25
6338	205	32	20	20	25	25	25
6330	205	28	20	20	25	25	25
6354	205	18	Desteklenmez	20	20	20	25
6346	205	16	Desteklenmez	20	20	20	25
8352V	195	36	20	20	25	25	25
8352M	185	32	20*	20*	25	25	25
6338N	185	32	20*	20*	25	25	25
5320	185	26	20*	20*	25	25	25
6336Y	185	24	20*	20*	25	25	25
6326	185	16	20*	20*	25	25	25
6330N	165	28	25	25*	25*	25*	25*
6338T	165	24	25	25*	25*	25*	25*
5318Y	165	24	25	25*	25*	25*	25*
5318S	165	24	25	25*	25*	25*	25*
6334	165	8	25	25*	25*	25*	25*
5318N	150	24	25*	30	30	30	30*
5320T	150	20	25*	30	30	30	30*
4316	150	20	25*	30	30	30	30*
5317	150	12	25*	30	30	30	30*
5315Y	140	8	30	30	30*	30*	30*
4314	135	16	30*	30*	30*	30*	30*
4310	120	12	35	35	35	35	35
4310T	105	10	35	35	35	35	35
4309Y	105	8	35	35	35	35	35

**İ NOT:**

- \* İşaretili veriler, bu yapılandırmada, HSK ile genişletilmiş işlemci 1 'kullanılıyorsa, +5°C'ye kadar sıcaklık aralığına sahip olabileceği anlamına gelir.
- H745, işlemci TDP > 185 W ile desteklenmez.
- PCIe > 25 Watt, 128 GB LRDIMM ve GPU yapılandırması için ek termal kısıtlamalar gereklidir.

**Tablo 20. Hava soğutmalı - İşlemci 1 için 2,5 inç doğrudan sürücü yapılandırmasına sahip tek işlemci için maksimum sürekli çalışma sıcaklığı**

İşlemciler	TDP (W)	Çekirdekler	6 x sürücü/ kızak	4 x sürücü/ kızak	2 x sürücü/ kızak	1 x sürücü/ kızak	BP yok
8380	270	40	20	20	20	20	25
8368	270	38	20	20	25	25	25
8368Q	270	38	Desteklenmez	Desteklenmez	Desteklenmez	Desteklenmez	Desteklenmez
8362	265	32	20	20	25	25	25
8360Y	250	36	20	20	25	25	25
8358	250	32	20	20	25	25	25
8358P	240	32	20	20	25	25	25
6348	235	28	25	25	25	25	30
6342	230	24	25	25	25	25	30
8351N	225	36	20	20	25	25	25
8352Y	205	32	30	30	35	35	35
6314U	205	32	30	30	35	35	35
8352S	205	32	30	30	35	35	35
6338	205	32	30	30	35	35	35
6330	205	28	30	30	35	35	35
6354	205	18	25	25	30	30	30
6346	205	16	25	25	30	30	30
8352V	195	36	30	30	30	30	35
8352M	185	32	35	35	35	35	35
6338N	185	32	35	35	35	35	35
5320	185	26	35	35	35	35	35
6336Y	185	24	35	35	35	35	35
6312U	185	24	35	35	35	35	35
6326	185	16	35	35	35	35	35
6330N	165	28	35	35	35	35	35
6338T	165	24	35	35	35	35	35
5318Y	165	24	35	35	35	35	35
5318S	165	24	35	35	35	35	35
6334	165	8	35	35	35	35	35
5318N	150	24	35	35	35	35	35
5320T	150	20	35	35	35	35	35
4316	150	20	35	35	35	35	35

**Tablo 20. Hava soğutmalı - İşlemci 1 için 2,5 inç doğrudan sürücü yapılandırmasına sahip tek işlemci için maksimum sürekli çalışma sıcaklığı (devamı)**

İşlemciler	TDP (W)	Çekirdekler	6 x sürücü/kızak	4 x sürücü/kızak	2 x sürücü/kızak	1 x sürücü/kızak	BP yok
5317	150	12	35	35	35	35	35
5315Y	140	8	35	35	35	35	35
4314	135	16	35	35	35	35	35
4310	120	12	35	35	35	35	35
4310T	105	10	35	35	35	35	35
4309Y	105	8	35	35	35	35	35

**i** NOT: PCIE > 25 Watt, 128 GB LRDIMM ve GPU yapılandırması için ek termal kısıtlamalar gereklidir.

**Tablo 21. Hava soğutmalı - 2,5 inç Yalnızca NVMe içeren sürücü yapılandırmasına sahip çift işlemci için maksimum sürekli çalışma sıcaklığı**

İşlemciler	TDP (W)	Çekirdekler	6 x sürücü/kızak	4 x sürücü/kızak	2 x sürücü/kızak	1 x sürücü/kızak
8380	270	40	Desteklenmez	Desteklenmez	Desteklenmez	Desteklenmez
8368	270	38	Desteklenmez	Desteklenmez	Desteklenmez	Desteklenmez
8368Q	270	38	Desteklenmez	Desteklenmez	Desteklenmez	Desteklenmez
8362	265	32	Desteklenmez	Desteklenmez	Desteklenmez	Desteklenmez
8360Y	250	36	Desteklenmez	Desteklenmez	Desteklenmez	Desteklenmez
8358	250	32	Desteklenmez	Desteklenmez	Desteklenmez	Desteklenmez
8358P	240	32	Desteklenmez	Desteklenmez	Desteklenmez	Desteklenmez
6348	235	28	Desteklenmez	Desteklenmez	Desteklenmez	Desteklenmez
6342	230	24	Desteklenmez	Desteklenmez	Desteklenmez	20
8352Y	205	32	20	20	25	25
8352S	205	32	20	20	25	25
6338	205	32	20	20	25	25
6330	205	28	20	20	25	25
6354	205	18	Desteklenmez	Desteklenmez	20	20
6346	205	16	Desteklenmez	Desteklenmez	20	20
8352V	195	36	20	20	25	25
8352M	185	32	20	20	25	25
6338N	185	32	20	20	25	25
5320	185	26	20	20	25	25
6336Y	185	24	20	20	25	25
6326	185	16	20	20	25	25
6330N	165	28	20*	20*	25*	25*
6338T	165	24	20*	20*	25*	25*
5318Y	165	24	20*	20*	25*	25*
5318S	165	24	20*	20*	25*	25*

**Tablo 21. Hava soğutmalı - 2,5 inç Yalnızca NVMe içeren sürücü yapılandırmasına sahip çift işlemci için maksimum sürekli çalışma sıcaklığı (devamı)**

İşlemciler	TDP (W)	Çekirdekler	6 x sürücü/kızak	4 x sürücü/kızak	2 x sürücü/kızak	1 x sürücü/kızak
6334	165	8	20*	20*	25*	25*
5318N	150	24	25	25	30	30
5320T	150	20	25	25	30	30
4316	150	20	25	25	30	30
5317	150	12	25	25	30	30
5315Y	140	8	25*	25*	30*	30*
4314	135	16	25*	25*	30*	30*
4310	120	12	30	30	35	35
4310T	105	10	30*	30*	35	35
4309Y	105	8	30*	30*	35	35

**Tablo 22. Hava soğutmalı - 3,5 inç doğrudan sürücü yapılandırmasına sahip çift işlemci için maksimum sürekli çalışma sıcaklığı**

İşlemciler	TDP (W)	Çekirdekler	3 x sürücü/kızak	2 x sürücü/kızak	1 x sürücü/kızak
8380	270	40	Desteklenmez	Desteklenmez	Desteklenmez
8368	270	38	Desteklenmez	Desteklenmez	Desteklenmez
8368Q	270	38	Desteklenmez	Desteklenmez	Desteklenmez
8362	265	32	Desteklenmez	Desteklenmez	Desteklenmez
8360Y	250	36	Desteklenmez	Desteklenmez	Desteklenmez
8358	250	32	Desteklenmez	Desteklenmez	Desteklenmez
8358P	240	32	Desteklenmez	Desteklenmez	Desteklenmez
6348	235	28	Desteklenmez	Desteklenmez	Desteklenmez
6342	230	24	Desteklenmez	Desteklenmez	Desteklenmez
8351N	225	36	Desteklenmez	Desteklenmez	Desteklenmez
8352Y	205	32	Desteklenmez	Desteklenmez	Desteklenmez
6314U	205	32	Desteklenmez	Desteklenmez	Desteklenmez
8352S	205	32	Desteklenmez	Desteklenmez	Desteklenmez
6338	205	32	Desteklenmez	Desteklenmez	Desteklenmez
6330	205	28	Desteklenmez	Desteklenmez	Desteklenmez
6354	205	18	Desteklenmez	Desteklenmez	Desteklenmez
6346	205	16	Desteklenmez	Desteklenmez	Desteklenmez
8352V	195	36	Desteklenmez	Desteklenmez	Desteklenmez
8352M	185	32	Desteklenmez	Desteklenmez	Desteklenmez
6338N	185	32	Desteklenmez	Desteklenmez	Desteklenmez
5320	185	26	Desteklenmez	Desteklenmez	Desteklenmez
6336Y	185	24	Desteklenmez	Desteklenmez	Desteklenmez
6312U	185	24	Desteklenmez	Desteklenmez	Desteklenmez

**Tablo 22. Hava soğutmalı - 3,5 inç doğrudan sürücü yapılandırmasına sahip çift işlemci için maksimum sürekli çalışma sıcaklığı (devamı)**

İşlemciler	TDP (W)	Çekirdekler	3 x sürücü/kızak	2 x sürücü/kızak	1 x sürücü/kızak
6326	185	16	Desteklenmez	Desteklenmez	Desteklenmez
6330N	165	28	Desteklenmez	Desteklenmez	20
6338T	165	24	Desteklenmez	Desteklenmez	20
5318Y	165	24	Desteklenmez	Desteklenmez	20
5318S	165	24	Desteklenmez	Desteklenmez	20
6334	165	8	Desteklenmez	Desteklenmez	20
5318N	150	24	Desteklenmez	Desteklenmez	20
5320T	150	20	Desteklenmez	Desteklenmez	20
4316	150	20	Desteklenmez	Desteklenmez	20
5317	150	12	Desteklenmez	Desteklenmez	20
5315Y	140	8	Desteklenmez	20	20*
4314	135	16	Desteklenmez	20*	20*
4310	120	12	20	25	25
4310T	105	10	25	30	30
4309Y	105	8	25	30	30

**Tablo 23. Hava Soğutmalı - 3,5 inç doğrudan sürücü yapılandırmasına sahip tek işlemci için maksimum sürekli çalışma sıcaklığı**

İşlemciler	TDP (W)	Çekirdekler	3 x sürücü/kızak	2 x sürücü/kızak	1 x sürücü/kızak
8380	270	40	Desteklenmez	Desteklenmez	Desteklenmez
8368	270	38	Desteklenmez	Desteklenmez	Desteklenmez
8368Q	270	38	Desteklenmez	Desteklenmez	Desteklenmez
8362	265	32	Desteklenmez	Desteklenmez	Desteklenmez
8360Y	250	36	Desteklenmez	Desteklenmez	Desteklenmez
8358	250	32	Desteklenmez	Desteklenmez	Desteklenmez
8358P	240	32	Desteklenmez	Desteklenmez	20
6348	235	28	Desteklenmez	20	20
6342	230	24	Desteklenmez	20	20
8351N	225	36	Desteklenmez	Desteklenmez	20
8352Y	205	32	20	25	25
6314U	205	32	20	25	25
8352S	205	32	20	25	25
6338	205	32	20	25	25
6330	205	28	20	25	25
6354	205	18	Desteklenmez	20	25
6346	205	16	Desteklenmez	20	25
8352V	195	36	20	25	25

**Tablo 23. Hava Soğutmalı - 3,5 inç doğrudan sürücü yapılandırmasına sahip tek işlemci için maksimum sürekli çalışma sıcaklığı (devamı)**

İşlemciler	TDP (W)	Çekirdekler	3 x sürücü/kızak	2 x sürücü/kızak	1 x sürücü/kızak
8352M	185	32	25	30	30
6338N	185	32	25	30	30
5320	185	26	25	30	30
6336Y	185	24	25	30	30
6312U	185	24	25	30	30
6326	185	16	25	30	30
6330N	165	28	25	30	30
6338T	165	24	25	30	30
5318Y	165	24	25	30	30
5318S	165	24	25	30	30
6334	165	8	25	30	30
5318N	150	24	30	35	35
5320T	150	20	30	35	35
4316	150	20	30	35	35
5317	150	12	30	35	35
5315Y	140	8	30	35	35
4314	135	16	30	35	35
4310	120	12	30	35	35
4310T	105	10	35	35	35
4309Y	105	8	35	35	35

**Tablo 24. Sıvı soğutmalı - 2,5 inç doğrudan / 2,5 inç NVMe sürücü yapılandırmasına sahip çift işlemci için maksimum sürekli çalışma sıcaklığı**

İşlemciler	TDP (W)	Çekirdekler	6 x sürücü/kızak	4 x sürücü/ kızak	2 x sürücü/kızak	1 x sürücü/kızak	BP yok
8380	270	40	35	35	35	35	35
8368	270	38	35	35	35	35	35
8368Q	270	38	35	35	35	35	35
8362	265	32	35	35	35	35	35
8360Y	250	36	35	35	35	35	35
8358	250	32	35	35	35	35	35
8358P	240	32	35	35	35	35	35
6348	235	28	35	35	35	35	35
6342	230	24	35	35	35	35	35
8352Y	205	32	35	35	35	35	35
8352S	205	32	35	35	35	35	35
6338	205	32	35	35	35	35	35
6330	205	28	35	35	35	35	35

**Tablo 24. Sıvı soğutmalı - 2,5 inç doğrudan / 2,5 inç NVMe sürücü yapılandırmasına sahip çift işlemci için maksimum sürekli çalışma sıcaklığı (devamı)**

İşlemciler	TDP (W)	Çekirdekler	6 x sürücü/ kızak	4 x sürücü/ kızak	2 x sürücü/ kızak	1 x sürücü/ kızak	BP yok
6354	205	18	35	35	35	35	35
6346	205	16	35	35	35	35	35
8352V	195	36	35	35	35	35	35
8352M	185	32	35	35	35	35	35
6338N	185	32	35	35	35	35	35
5320	185	26	35	35	35	35	35
6336Y	185	24	35	35	35	35	35
6326	185	16	35	35	35	35	35
6330N	165	28	35	35	35	35	35
6338T	165	24	35	35	35	35	35
5318Y	165	24	35	35	35	35	35
5318S	165	24	35	35	35	35	35
6334	165	8	35	35	35	35	35
5318N	150	24	35	35	35	35	35
5320T	150	20	35	35	35	35	35
4316	150	20	35	35	35	35	35
5317	150	12	35	35	35	35	35
5315Y	140	8	35	35	35	35	35
4314	135	16	35	35	35	35	35
4310	120	12	35	35	35	35	35
4310T	105	10	35	35	35	35	35
4309Y	105	8	35	35	35	35	35

**i** | **NOT:** PCIe > 25 Watt, 128 GB LRDIMM ve GPU yapılandırması için ek termal kısıtlamalar gereklidir.

**Tablo 25. Sıvı soğutmalı - 2,5 inç Yalnızca NVMe içeren sürücü yapılandırmasına sahip çift işlemci için maksimum sürekli çalışma sıcaklığı**

İşlemciler	TDP (W)	Çekirdekler	6 x sürücü/ kızak	4 x sürücü/ kızak	2 x sürücü/ kızak	1 x sürücü/ kızak
8380	270	40	35	35	35	35
8368	270	38	35	35	35	35
8368Q	270	38	35	35	35	35
8362	265	32	35	35	35	35
8360Y	250	36	35	35	35	35
8358	250	32	35	35	35	35
8358P	240	32	35	35	35	35
6348	235	28	35	35	35	35
6342	230	24	35	35	35	35

**Tablo 25. Sıvı soğutmalı - 2,5 inç Yalnızca NVMe içeren sürücü yapılandırmasına sahip çift işlemci için maksimum sürekli çalışma sıcaklığı (devamı)**

İşlemciler	TDP (W)	Çekirdekler	6 x sürücü/ kızak	4 x sürücü/ kızak	2 x sürücü/ kızak	1 x sürücü/ kızak
8352Y	205	32	35	35	35	35
8352S	205	32	35	35	35	35
6338	205	32	35	35	35	35
6330	205	28	35	35	35	35
6354	205	18	35	35	35	35
6346	205	16	35	35	35	35
8352V	195	36	35	35	35	35
8352M	185	32	35	35	35	35
6338N	185	32	35	35	35	35
5320	185	26	35	35	35	35
6336Y	185	24	35	35	35	35
6326	185	16	35	35	35	35
6330N	165	28	35	35	35	35
6338T	165	24	35	35	35	35
5318Y	165	24	35	35	35	35
5318S	165	24	35	35	35	35
6334	165	8	35	35	35	35
5318N	150	24	35	35	35	35
5320T	150	20	35	35	35	35
4316	150	20	35	35	35	35
5317	150	12	35	35	35	35
5315Y	140	8	35	35	35	35
4314	135	16	35	35	35	35
4310	120	12	35	35	35	35
4310T	105	10	35	35	35	35
4309Y	105	8	35	35	35	35

**i** NOT: PCIE > 25 Watt, 128 GB LRDIMM ve GPU yapılandırması için ek termal kısıtlamalar gereklidir.

**Tablo 26. Sıvı soğutmalı - 3,5 inç doğrudan sürücü yapılandırmasına sahip çift işlemci için maksimum sürekli çalışma sıcaklığı**

İşlemciler	TDP (W)	Çekirdekler	3 x sürücü/kızak	2 x sürücü/kızak	1 x sürücü/kızak
8380	270	40	35	35	35
8368	270	38	35	35	35
8368Q	270	38	35	35	35
8362	265	32	35	35	35
8360Y	250	36	35	35	35

**Tablo 26. Sıvı soğutmalı - 3,5 inç doğrudan sürücü yapılandırmasına sahip çift işlemci için maksimum sürekli çalışma sıcaklığı (devamı)**

İşlemciler	TDP (W)	Çekirdekler	3 x sürücü/kızak	2 x sürücü/kızak	1 x sürücü/kızak
8358	250	32	35	35	35
8358P	240	32	35	35	35
6348	235	28	35	35	35
6342	230	24	35	35	35
8352Y	205	32	35	35	35
8352S	205	32	35	35	35
6338	205	32	35	35	35
6330	205	28	35	35	35
6354	205	18	35	35	35
6346	205	16	35	35	35
8352V	195	36	35	35	35
8352M	185	32	35	35	35
6338N	185	32	35	35	35
5320	185	26	35	35	35
6336Y	185	24	35	35	35
6326	185	16	35	35	35
6330N	165	28	35	35	35
6338T	165	24	35	35	35
5318Y	165	24	35	35	35
5318S	165	24	35	35	35
6334	165	8	35	35	35
5318N	150	24	35	35	35
5320T	150	20	35	35	35
4316	150	20	35	35	35
5317	150	12	35	35	35
5315Y	140	8	35	35	35
4314	135	16	35	35	35
4310	120	12	35	35	35
4310T	105	10	35	35	35
4309Y	105	8	35	35	35

**i** NOT: PCIE > 25 Watt, 128 GB LRDIMM ve GPU yapılandırması için ek termal kısıtlamalar gereklidir.

## ASHRAE A3 Yapılandırma Kısıtlaması

**Tablo 27. ASHRAE A3 Yapılandırma Kısıtlaması**

Sıvı soğutmalı	Hava soğutmalı
<ul style="list-style-type: none"><li>• NVMe SSD desteklenmez.</li><li>• LRDIMM desteklenmez.</li><li>• 25 W üstü PCIe kartları desteklenmez.</li><li>• GPU kartı desteklenmez.</li><li>• 3,5 inç sürücü yapılandırması desteklenmez.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• NVMe SSD desteklenmez.</li><li>• LRDIMM desteklenmez.</li><li>• 25 W üstü PCIe kartları desteklenmez.</li><li>• GPU kartı desteklenmez.</li><li>• 3,5 inç sürücü yapılandırması desteklenmez.</li><li>• 1P kızak için, maksimum desteklenen CPU TDP 150 W'tır.</li><li>• 2P kızak için, maksimum desteklenen CPU TDP 105 W'tır.</li></ul>